

〔国際会議発表〕

発表研究者	同志社大学大学院 博士後期課程 松井 翔太	2192108
参加会議	22 nd International Conference on Advances in Materials & Processing Technologies (AMPT2019)	
開催場所	台北市・台湾	
出張期間	2019 年 10 月 19 日～2019 年 10 月 24 日	
発表論文	Smart Monitoring of Helical Thread Mill Process with a Wireless Tool Holder and CNC Information	

概要：

材料および加工の分野で世界的に有名な国際会議である，22nd International Conference on Advances in Materials & Processing Technologies（AMPT2019）に参加し，私は，“Smart Monitoring of Helical Thread Mill Process with a Wireless Tool Holder and CNC Information”のタイトルにて口頭発表をおこなった。本発表は，最新のワイヤレスホルダを使用することにより，従来は熟練作業者が手作業でおこなっている加工の解明が目的である。

口頭発表の際には，多くの研究者から質問を受けた。質問の中には，私自身では，気が付くことができなかったことや，今後の研究のアドバイス等興味深い意見が多々あり有意義な討論をおこなうことができた。本テーマは，人間がおこなう作業を解明し，機械加工にて同一の加工をおこなうことを目標としているため，人間と機械の調和にも重要な意義があり，世界的な国際会議でも十分にアピールすることが出来たと考えている。また，私自身も世界的な研究者が集まる会議にて討論をおこなった経験は，今後のキャリアにつながる重要な意味があったイベントであった。